索联物联网
Solin IOT

eSIM-DNF2*2芯片卡规格书

V1.2

上海索联物联科技有限公司

M2M(DFN8 2*2)eSIM卡产品规格书

为了设计人员能更快捷，准确地选择适合设计需求的产品，并使该产品能顺利通过认定程序和入厂检验，特提供产品规格书如下：

1 产品一般描述（Description）

1.1 产品适用范围(Applicability scope)

M2M 专用卡通过专业的软硬件改造，可以广泛应用在绝大多数行业中，相比传统普通 SIM 卡在工作温度范围、抗震、抗湿等方面均能满足更高的要求。

1.2 工作环境要求(Working environment)

MS0 卡硬件指标列表

	指标等级
擦写次数	10万次
数据保存时间	10 年
操作温度(包括工作温度和存储温度)	-25 to +85° C
湿度	+50℃，相对湿度范围90%~95%，1000小时的条件下，卡可正常工作及存储。
静电	在卡暴露在2000V的静电环境中，不应降低卡片功能。
电磁	在卡暴露在稳定的79500A/m（1000Qe）磁场下，不应降低卡片功能。
X光(紫外线)	卡的任何一面在接受总能量为15Ws/cm2 的紫外线光照后，卡应能保证正常工作。
震动	20Hz～2000Hz的振动环境下至少2小时，卡可正常工作及存储。
规格	DFN2*2-8 封装

2 产品规格内容(Specification)

2.1 产品外观检查标准(Appearance specification)

产品长×宽×高：2.0mm×2.0mm，厚度小于等于0.8mm，相关尺寸及外形如图2.1、图2.2、表2.1

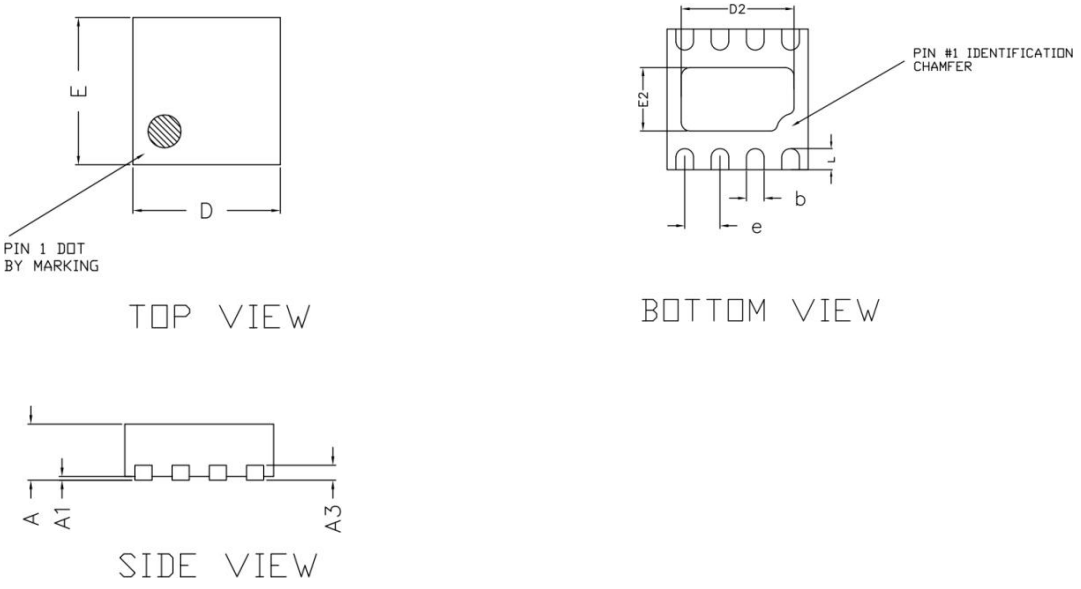


图 2.1



图 2.2

COMMON DIMENSIONS(MM)			
PKG.	W:VERY VERY THIN		
REF.	MIN.	NOM.	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0.00	-	0.05
A3	0.2 REF.		
D	1.95	2.00	2.05
E	1.95	2.00	2.05
b	0.20	0.25	0.30
L	0.20	0.30	0.40
D2	1.45	1.60	1.70
E2	0.75	0.90	1.00
e	0.50 BSC		

表 2.1

DFN2*2-8 芯片的 8 个管脚中，5 个管脚应与无线模块的相应设备相连，3 个管脚不用。图 2.3 为管脚定义：

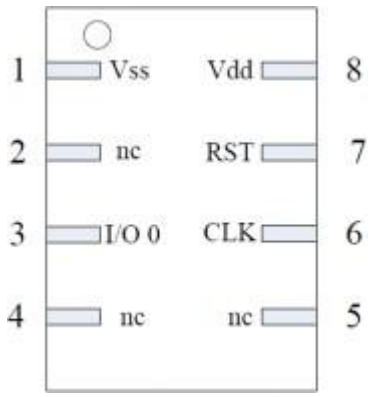


图 2.3 DFN2*2-8 封装芯片管脚定义示意图

表 2.2 为管脚定义：

管脚序号	触点信号	解释
1	VSS	接地
2	NULL	未定义
3	I/O	数据输入/数据端口
4	NULL	未定义
5	NULL	未定义
6	CLK	时钟信号输入端
7	RST	复位信号输入端
8	VDD	供电电压输入端

表 2.2　DFN2*2-8 封装芯片管脚定义列表

2.2　产品电气特性（结构件除外）(Electronic specification)

电气特性遵循《中国移动通信业务卡管理体系-SIM 卡基础技术规范（2001 年 12 月）》和《ISO/IEC 7816-3》规范要求

3　包装规格内容(Package specification)

3.1　包装要求

批量生产时采用卷带真空包装方式： 2000 片/卷(可根据客户要求调整)；卷盘的外径尺寸：7 英寸；卷带的宽度：9mm。

芯片在载带中放置时，有触点面朝下。

卷带在卷盘上缠绕时， 卷带的前端和后端需要留出空的卷带，前端留出约 8cm 长的载带，后端留出约 16cm 长的载带，载带后端的上带需要多留出 8~10cm 长度，用透明胶带在接口处贴紧。见图 3.1 及 3.2。

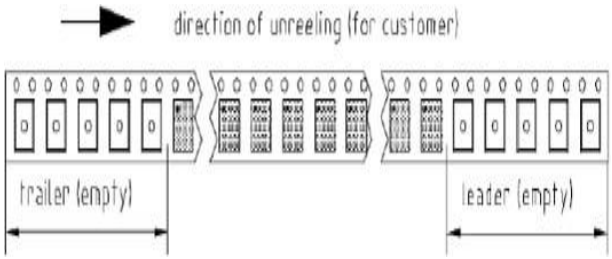


图 3.1

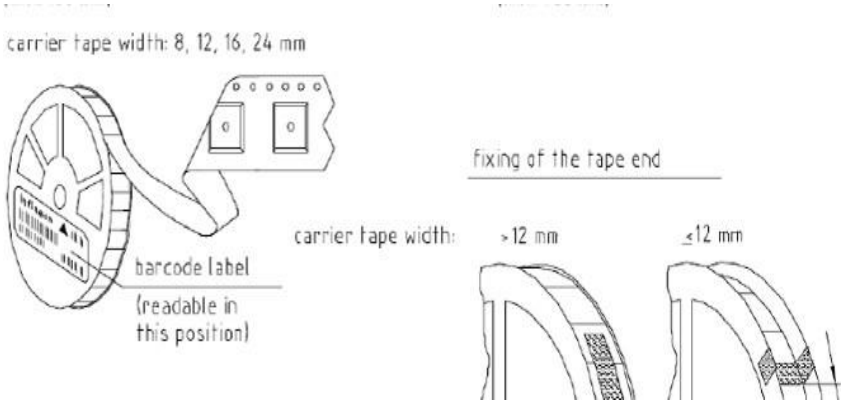


图 3.2

卷带装盒方式及标签样式： 1 卷（2000 片）/盒，10 盒（20000 片）/箱。

2*2 载带

